



2021年8月2日

各 位

会 社 名 株式会社インターアクション
代表者名 代表取締役社長 木地 伸雄
(コード番号 7725 東証第一部)
問合せ先 経 営 企 画 室 I R 担 当
電話番号 045-263-9220

長崎大学との共同研究開始に関するお知らせ

当社は、長崎大学との間において高脆性材料こうぜいせいの加工に関する共同研究を開始いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

1. 研究内容ならびに目的

様々な半導体の中でも、電力の制御や変換を行うパワー半導体は、テレビやエアコンといった家電や電気自動車、太陽光発電、鉄道など幅広い分野に使用され、我々の生活に必要不可欠となっております。

現在、パワー半導体の主な材料としてシリコン (Si) が用いられておりますが、近年では、電力損失が発生しにくく、かつ高電圧に対応可能なシリコンカーバイド (SiC) 等の素材を用いた次世代パワー半導体が注目を集めております。しかしながら、SiC等の素材はSiと比較して硬くて脆い高脆性材料こうぜいせいのため、加工が難しいといった課題があります。

本共同研究では、SiC等の高脆性材料こうぜいせいの効率的な加工方法について研究を行い、新たな加工装置の開発を行うことを目的としており、研究期間は2024年3月31日までを予定しております。

2. 今後の見通し

本共同研究が2022年5月期に与える影響は軽微であります。

以上